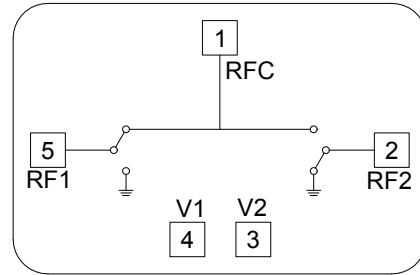


特点:

- 反射式 SP2T 开关
- 频率: 0.5~6GHz
- 插入损耗: 0.6dB
- 隔离度: 40dB
- 工作温度: -55~+85℃
- 芯片尺寸: 0.98×0.82×0.1mm

功能框图



性能参数: ($T_A=+25^{\circ}\text{C}$, $V_{\text{Ctrl}}=0/+5\text{V}$ 或 -5V)

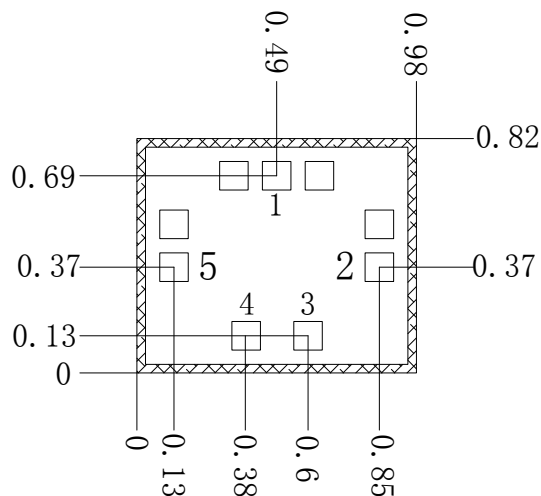
参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
频率范围	f	$Z_{\text{in}}=Z_{\text{out}}=50\Omega$ $P_{\text{in}}=0\text{dBm}$ $V_{\text{Ctrl}}=0/+5\text{V}$ 或 -5V	0.5		6	GHz	
插入损耗	IL			0.6	1	dB	
隔离度	ISO		30	40		dB	
输入驻波	VSWR _i			1.4	2		
输出驻波	VSWR _o			1.4	2		
输入 P_{-1}	P_{-1}			30		dBm	
开关时间	t			15		ns	

极限参数表:

参数名称	极限值	单位	参数名称	极限值	单位
最大输入功率	+30	dBm	贮存温度	-55~+150	℃
控制电压	低电平: 0~0.5	V			
	高电平: 4.5~5.5 或 -4.5~-5.5				

芯片尺寸图:

单位: mm



注: 典型键合焊盘尺寸为 100*100um

引脚定义：

引脚	定义	描述
1	RFC	射频输入，DC 耦合,需外接隔直电容
2, 5	RF2, RF1	射频输出，DC 耦合,需外接隔直电容
3, 4	V2, V1	开关控制端
芯片背面	GND	芯片背面必须接至 RF/DC 地

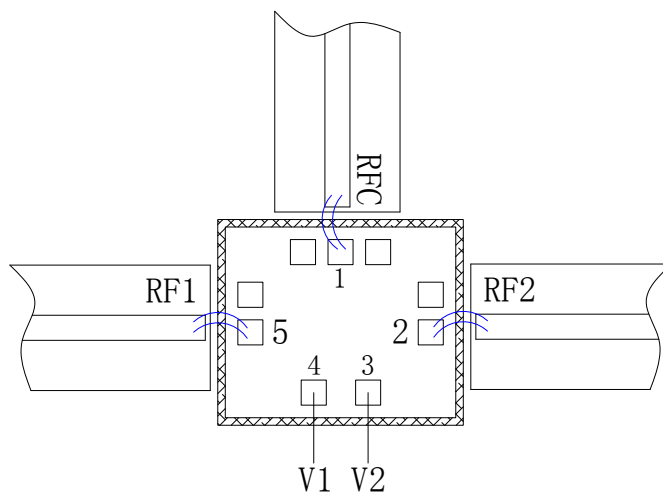
真值表：(0: 0V, 1: +5V)

控制输入		通断状态	
V1	V2	RFC-RF1	RFC-RF2
0	1	ON	OFF
1	0	OFF	ON

真值表 2：(0:0V, 1: -5V)

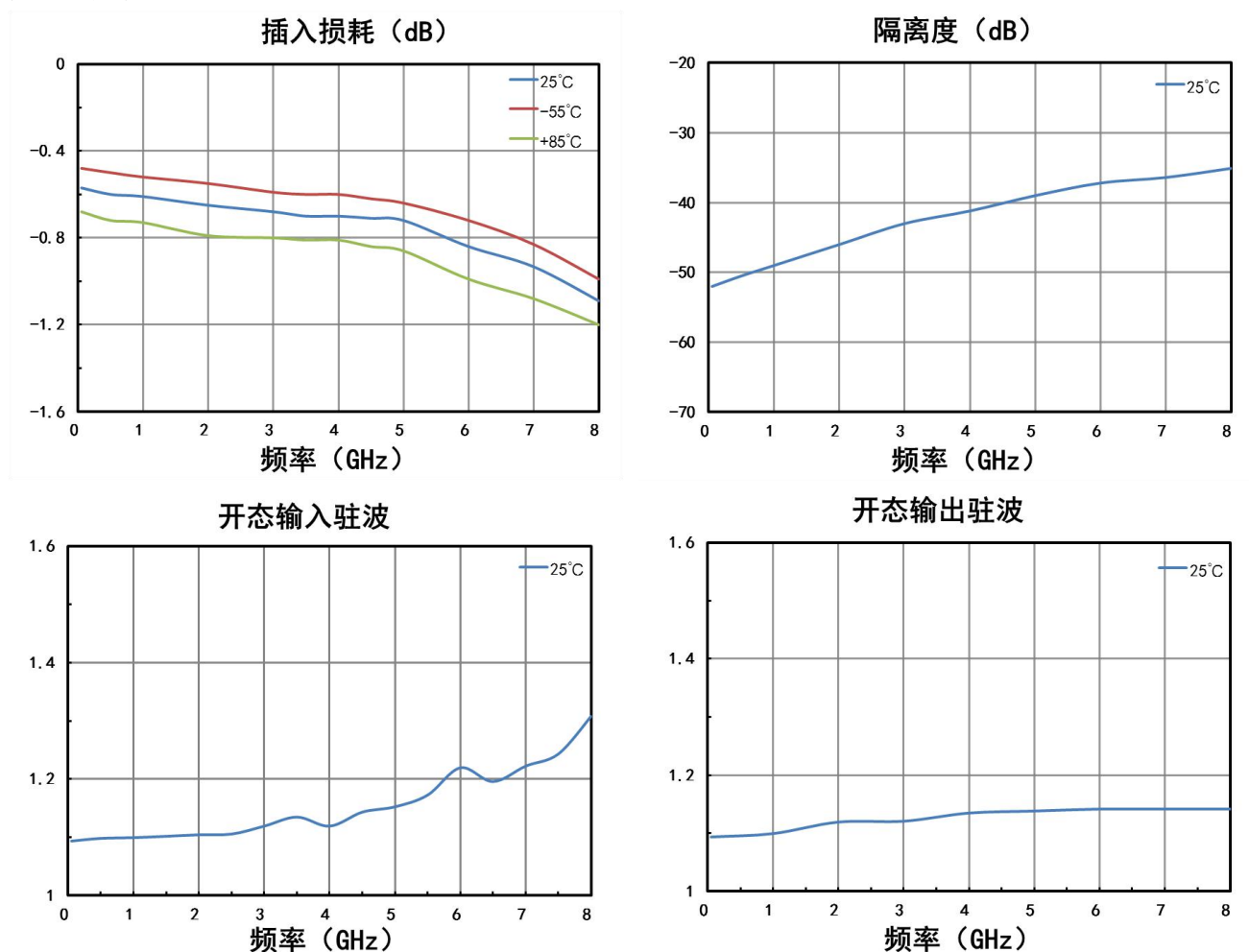
控制输入		通断状态	
V1	V2	RFC-RF1	RFC-RF2
0	1	ON	OFF
1	0	OFF	ON

推荐装配图：



注：未标注的键合焊盘不需要连接

典型测试曲线：



产品使用注意事项：

1. 本芯片产品需要在干燥、氮气环境中存储，在超净环境装配使用；
2. 裸芯片使用的 GaAs 材料较脆，芯片表面容易受损，不能用干或湿化学方法清洁芯片表面使用时必须小心；
3. 芯片底部用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 295℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与微带线间歇不超过 3 mil，使用 1 mil 双金丝键合，其他端口使用 1 mil 单金丝，建议金丝长度 10~16 mil；
5. 产品对静电敏感，在存储和使用过程中注意防静电；
6. 其他使用说明详见《裸芯片产品使用说明》。